

证券代码： 003043

证券简称：华亚智能

苏州华亚智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	开源证券 张越 泰康资产 蔺皓天 光大保德信 王卫林 昶元投资 张唯杰 晋信基金 晏建树 研几资本 刘彪 刘涛 建信基金 张池 鹤禧投资、交银施罗德、建信基金、淳阳基金等 21 名相关投资者
时间	2026年8月31日 15:15-16:15
地点	公司现场
上市公司接待人员姓名	董事长 王彩男 董秘 杨桉博 证代 许湘东
投资者关系活动主要内容介绍	1.问：公司半导体业务主要产品及核心竞争力是什么？ 答：公司产品为主要用于半导体设备的精密金属结构件。核心竞争力在于集成了数控、焊接、表面处理、机加工等多项技术能力，以及深度参与客户研发形成的技术服务黏性。半导体设备厂商认证周期长、门槛高，公司深耕行业多年，积累了丰富的“小批量、多品种”加工经验。 2.问：半导体设备零部件具体包括哪些产品？ 答：半导体设备零部件种类繁多、因设备而异。以薄膜沉积设备为例，整机零部件分为腔体、真空、气体输送、射频/电源、温控、工艺监测、电气控制等系统模块。公司产品为精密金属结构件，即应用于薄膜沉积、刻蚀、光刻、去胶、印刷、封装等设备的架

	台类和精密钣金类产品。 3.问：半导体零部件紧缺情况如何？ 答：随着下游智能类应用需求扩张，相关生产设备的需求提升，也因此带动半导体零部件需求增长。 4.问：澳科泰克是生产加热盘的吗？ 答：澳科泰克目前主营业务为半导体设备阀门部件维修。 5.问：公司订单可预见周期如何？ 答：公司与客户签订框架协议，客户提供未来半年至一年需求预测，实际订单以下单为准。自2024年下半年开始，智能类应用需求带动半导体行业回暖，2025年国内外需求均增长。后续收入增速取决于产能释放、客户需求持续性及生产效率提升。 6.问：目前产能利用率情况如何？ 答：新工厂投入使用，产能逐步扩大，目前处于爬坡阶段。产能释放速度取决于订单量、结构和产品类型。研发类产品从研发到量产需一至两年以上时间。目前，公司产能利用率较高。 7.问：订单交付周期多长？ 答：产品不同，交付周期各异，有的不足一个月，有的需一至数月。当前需求加快，基本交付周期为1-2个月。 8.问：公司月度收入规模及半导体业务占比如何？ 答：目前每月营业收入规模情况正常，半导体业务占比较高。 9.问：公司客户结构及海内外占比如何？ 答：公司客户包括国外知名半导体设备厂商及国内头部企业，国外客户营收占比高于国内。海外产品较成熟、有批量，国内产品多处于样机及小批量爬坡阶段。公司在满足海外需求的同时，积极拓展国内客户，均衡布局以分散风险。 10.问：海外较高毛利率水平能否长期维持达到40%或以上？ 答：公司产品呈现高度定制化、小批量、多品种的特点。营收及毛利率受当期客户需求量、产品结构、人力及材料成本影响较大。附加值高的产品需求量大时，同等成本下，毛利率较高，反之较低。 11.问：未来3年主营业务营收能否达到20亿元、30亿元？ 答：公司将持续做大做强主营业务。未来具体营收取决于行业发展及市场需求能否持续稳定向好等因素影响。 12.问：AMAT采购情况及公司占其比重如何？
--	--

	答：AMAT目前还不是公司的直接客户。 13.问：海外工厂的定位是什么？ 答：海外工厂未来以承接海外半导体客户为主，产能提升后亦承接部分国内客户的海外公司订单。公司关注东南亚半导体和智能类应用领域的活跃机会。 14.问：明年汇兑损益预期如何？ 答：公司积极管理汇兑风险：缩短账期、加快回款结汇；利用远期结售汇等工具锁定远期汇率等。 15.问：公司所在行业竞争格局如何？ 答：钣金加工厂家众多，但年销售额超1亿元的厂家较少，行业以小厂为主。国内半导体设备钣金件、结构件领域进口替代趋势明显，国产化率持续提高。公司在细分领域具有较强的竞争力。 16.问：公司是否涉及光芯片相关业务？ 答：公司主营包括半导体设备精密金属结构件，未涉及光芯片业务。公司将关注市场新业务、新技术和新机会。若涉及并达到信披要求的事项，公司将按照相关规定及时披露。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	/
日期	2026年8月31日